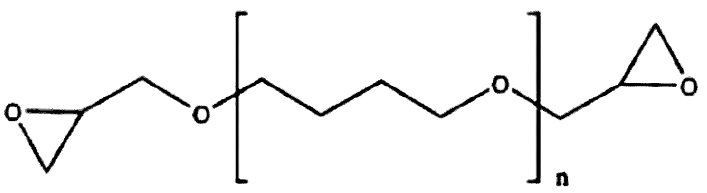
【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】令和7年1月31日(2025.1.31)

【国際公開番号】WO2023/062877
【出願番号】特願2023-554254(P2023-554254)
【国際特許分類】
C09K 3/10(2006.01)
C08L 63/00(2006.01)
C08K 3/013(2018.01)
H01L 23/29(2006.01)
【FI】
C09K 3/10 L
C08L 63/00 C
C08K 3/013
H01L 23/30 R

【手続補正書】
【提出日】令和7年1月23日(2025.1.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
エポキシ樹脂、硬化剤、硬化触媒、及びフィラーを含有し、
１２０℃で、１００秒間～６２０秒間のゲルタイムを有する、
液状封止剤。
【請求項２】
１２０℃で、０．５Ｐａ・ｓ～４０．０Ｐａ・ｓの粘度を有する、
請求項１に記載の液状封止剤。
【請求項３】
前記エポキシ樹脂が、脂肪族エポキシ樹脂、及び芳香族エポキシ樹脂を含有する、
請求項１又は請求項２に記載の液状封止剤。
【請求項４】
前記脂肪族エポキシ樹脂が、下記一般式（１）で示される分子構造を有し、かつ、２００～２，０００の数平均分子量を有する、
請求項３に記載の液状封止剤。
【化１】



一般式（１）

一般式（１）中、ｎは、１～１５の自然数である。
【請求項５】
前記硬化剤が、フェノールを含有する、

請求項１又は請求項２に記載の液状封止剤。
【請求項６】
前記硬化剤の含有量が、前記液状封止剤から前記フィラーを除いた残りの成分に対して、１．０質量％～２０．０質量％である、
請求項１又は請求項２に記載の液状封止剤。
【請求項７】
前記フィラーが、０．０５μｍ～１０μｍの体積平均粒径を有する、
請求項１又は請求項２に記載の液状封止剤。
【請求項８】
前記硬化触媒が、窒素原子を含有する複素環化合物である、
請求項１又は請求項２に記載の液状封止剤。
【請求項９】
前記硬化触媒の含有量が、前記エポキシ樹脂に対して１．０質量％～１２．０質量％である、
請求項１又は請求項２に記載の液状封止剤。
【請求項１０】
支持体と、請求項１又は請求項２に記載の液状封止剤の硬化物と、
を含む電子部品。
【請求項１１】
支持体と、前記支持体上に配されている半導体素子と、の間の空隙を、請求項１又は請求項２に記載の液状封止剤により充填することと、
前記液状封止剤を硬化することと、を含む、
電子部品の製造方法。
【請求項１２】
請求項１０に記載の電子部品を含む、
半導体装置。